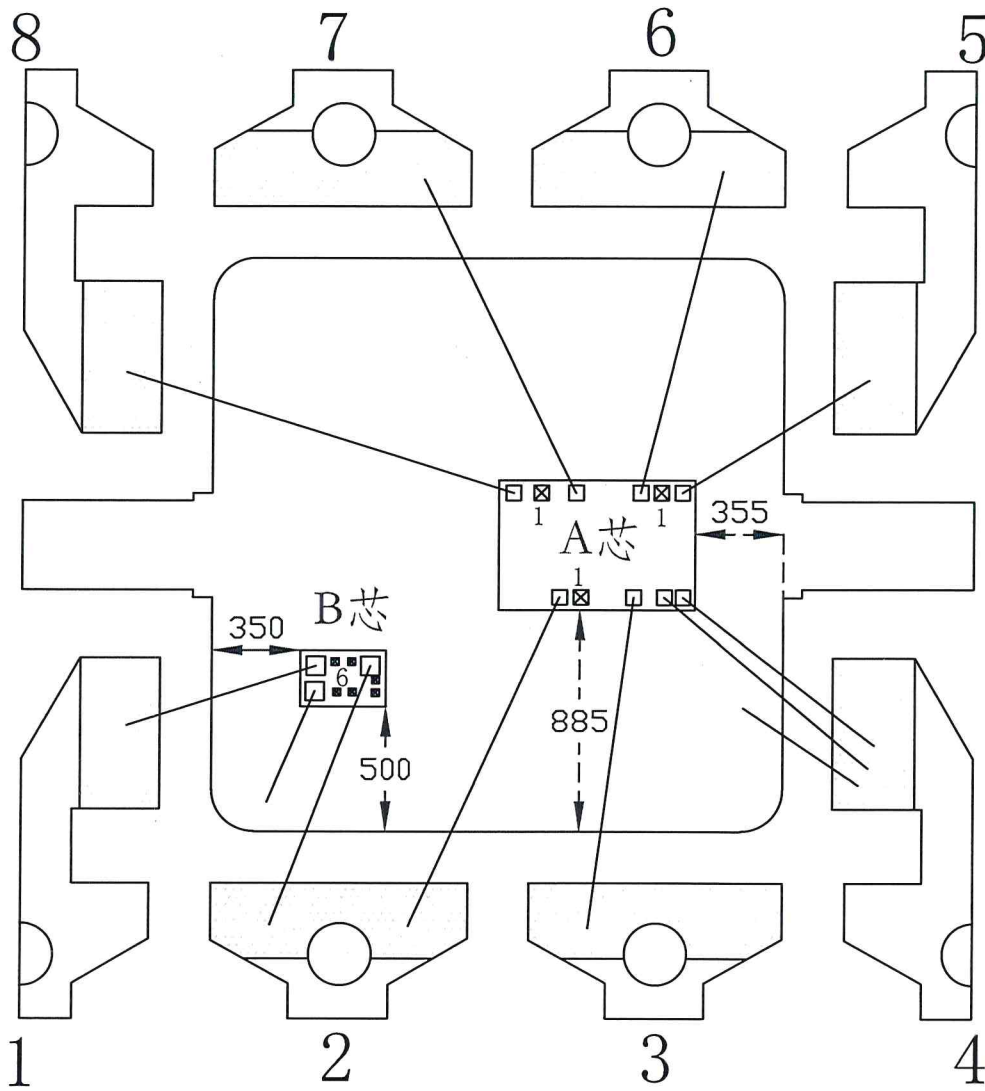


<div>池州华宇电子科技股份有限公司</div> <div>CHI ZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD</div> <div>焊线图纸 Bonding Diagram</div>				客户代码 Customer No.	008	线号 Drawing No.	HY-PX-008-771 A	
				产品名称 Product Type	HS6601L-33		封装外型 PKG Type	SOP8L (12R)
焊线种类 Wire Type	焊线直径(μm) Wire Diameter	焊线根数 NO. of wire	焊线总长(μm) Total wire length	最长线长(μm) Longest wire length	最短线长(μm) Shortest wire length	塑封料型号(绿色环保) Compound Type (Green)		LF载体尺寸 LF Pad Size
合金丝 Ag	20	12	15657	1617	555	首选(Preferred): EME-G630AY 备选(Optional): CEL-1702HF		SOP8L-12R (90°90mil) 2286*2286μm²
客户图号 Customer drawing NO.								



框架传送方向 (装片): L/F Direction (D/A): 椭圆孔	实物图: Chip photo:	特殊说明 Special Instructions: DB注意: 1.以施工单要求按顺序装片,如:先装A芯片,装B芯片时必须装在有A芯片的框架,反之先装B芯片,装A芯片时B芯片已经装片; 2.控制溢胶,为WB预留焊线位置; WB注意: 1.数字为不打线pad点个数;  产品HS6601L-33对应: 8R: HY-PX-008-638 A 12R: HY-PX-008-771 A
--	---------------------	--

说明 Instructions	粘片胶类型 Epoxy type	芯片名称 Die name	芯片尺寸 Die Size	最小焊盘尺寸 Min BPO (μm <sup>2</sup> )	最小焊盘间距 Min BPP (μm)	铝垫厚度(μm) Pad Thickness	焊盘下是否有电路 Circuit under Pad	划片道宽度 Street line (μm)	晶圆尺寸 Wafer Size	是否是 Low-κ? If low-κ?	减薄厚度 (μm) R. after Thinning
A芯: DIE A	导电胶 (conductivity) S210	HS5089	790*518(μm <sup>2</sup> ) 31.1*20.3(mil <sup>2</sup> )	60*60	75	1.0	是/Yes	60	8	否/NO	300
B芯: DIE B	导电胶 (conductivity) S210	TX6216	340*225(μm <sup>2</sup> ) 13.3*8.8(mil <sup>2</sup> )	75*75	101	2.75	是/Yes	60	8	否/NO	300
C芯: DIE C											
拟制 Prepared by	谢林. 2024.6.7		制图日期 Create Date	2024/6/7		生效日期 Effective Date	客户确认签字/盖章: Customer Signature				
研发审核 R&D Check	无铅. 2024.6.7		产品工程审核 PE Check			批准 Approved by					